

公司概況資料表

以下資料由暉盛科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- 認購相關資訊
- 公司簡介
- 主要業務項目
- 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- 最近五年度簡明資產負債表
- 最近三年度財務比率

公司名稱：暉盛科技股份有限公司 (股票代號：7730)

董事長	宋俊毅
總經理	許嘉元
資本額	新臺幣288,597,760元
輔導推薦證券商	福邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	福邦證券股份有限公司/李小姐(02)23836888#875
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購暉盛科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	福邦證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
認購日期	113年03月11日	
認購股數(股)	766,000	240,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.65%	0.83%
認購價格	每股新台幣106元	

認購價格之訂定
依據及方式

本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及收益法等方式，以推算合理之認購價格，作為暉盛科技股份有限公司(以下簡稱暉盛公司或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

目前股票價值評估方法眾多，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

1. 市價法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整。
2. 成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
3. 收益法：係根據目標公司預估未來營運可能創造之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

上述股票評價方法，其中因成本法係以歷史成本為計算之基礎，不足以代表成長性之股票未來的獲利水準，且易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，亦深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值。而收益法因預測期間較長，且預估所需參數較多，整體估測風險相對較高，亦難表達股票的合理價值。股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。暉盛公司近年來營運規模逐漸成長，屬獲利穩定且為成長型類股之族群，因此本輔導推薦證券商僅就市價法-本益比法作為該公司興櫃認購價格之評估基準。

暉盛公司主要從事各式電漿設備及其製程方案之研發、製造與銷售，主力產品為電漿表面處理之乾性設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及表面改質之處理，電漿設備應用廣泛，公司目前產品主要應用於半導體、PCB 及光電等電子產業；經檢視其相關產業及同業資料，以其產品種類、市場之競爭地位及公司的獲利能力等因素，並考量營運模式、產品性質及應用領域較為相近之業者，選取之同業如下：

1. 上櫃公司友威科技(股)公司(股票代碼：3580)：主要從事生產銷售真空濺鍍設備及乾式電漿蝕刻機設備，以及真空鍍膜代工業務。
2. 上櫃公司鈦昇科技(股)公司(股票代碼：8027)：主要從事半導體封裝設備及 PCB 軟板設備之生產與銷售，產品類別包

含雷射設備、電漿設備、軟板設備等。

3. 上市公司天虹科技(股)公司(股票代碼：6937)：主要從事高真空電漿應用解決方案的半導體前端製程設備及零組件之研發及銷售。

茲將其採樣同業、上櫃及上市半導體類股於證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所股份有限公司所公告最近三個月(112年11月~113年1月)之本益比資訊列示如下：

採樣同業	期間			
	112年11月	112年12月	113年1月	平均
友威科(3580)	12.82	14.43	14.43	13.89
鈦昇(8027)	131.43	158.23	193.48	161.05
天虹(6937)	41.60	42.15	37.07	40.27
上櫃半導體業	28.32	28.70	29.51	28.84
上市半導體業	18.27	18.94	19.54	18.92

資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心網站及福邦證券整理。

註1：天虹112年11月尚未上市掛牌，該月本益比為券商依當月月均價/最近4季 EPS 自行計算。

由上表得知，該公司採樣同業、上櫃半導體業類股及上市半導體業類股最近三個月(112年11月~113年01月)之本益比中，鈦昇及天虹因與採樣同業及類股偏離過高，故不予採納設算，排除極端值後其他採樣同業之平均本益比介於13.89~28.84倍之間。若以該公司111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱財務報告之最近四季(111年第三季至112年第二季)稅後淨利為204,037千元，依擬興櫃掛牌時股份總數28,860仟股計算之每股盈餘7.07元為計算基礎，價格區間為98.20元~203.90元。考量興櫃市場股票流通性風險以七折計算之每股參考價格合理區間為68.74元~142.73元，本輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股106元，介於合理價格區間內，故該公司興櫃認購價格之依據及議定方式應屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

暉盛科技股份有限公司(以下簡稱暉盛公司或該公司)設立於民國91年06月11日，為專注電漿領域技術之設備商，從產品設備研發、設計、製造到行銷及技術支援，皆具有高度完整之自主性與整合性。為因應現今主流環保意識訴求及工業產品微細化趨勢，公司於環保領域亦致力發展電漿殺菌、廢氣處理、空氣淨化等相關技術處理毒氣及廢水，取代傳統大量用水及造成廢水汙染環境，且目前主力設備聚焦於電漿表面處理之乾式設備，主要產品包含各式電漿清洗機、電漿去膠渣機及蝕刻機、電漿極化機與電漿表面處理機等設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及

表面改質之處理。該公司具備高密度電漿與製程應用的專利技術，產品可應用領域廣泛，目前主要應用為半導體、印刷電路板及光電等電子產業，也逐漸普及於各式非電子業、民生工業及生物醫療技術領域，近年更成功開發先進封裝半導體製程領域高效能電漿蝕刻應用產品，並持續精進各領域電漿應用之發展。

暉盛公司經營及技術團隊於電漿技術領域已有 20 年以上之產業經驗，多年來鑽研高蝕刻率、高均勻度的電漿處理技術，運用公司精良之技術與製程，可根據國內外客戶個別產線的需求，提出客製化之製程解決方案，並提供具有高性價比的設備及在地化之後勤服務。暉盛公司現已打入多個國際知名大廠之供應鏈，未來將持續針對產業鏈之歐美或日本著名品牌客戶，進行電漿技術之合作及取得認證，以確保暉盛公司在該產業鏈的銷售地位。

二、歷史沿革

年度	重要紀事
91 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 公司成立，實收資本額為新臺幣 32,000 千元。 ◆ 以開發先進電漿(Plasma)技術及製作各式電漿設備為營運主軸。初期以半導體及印刷電路板等電子領域客戶為銷售對象。
92 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 現金增資 24,530 千元，實收資本額 56,530 千元。 ◆ 跨足並銷售電漿設備至平面顯示器等光電領域。
93 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 成功開發多款大氣式電漿設備並開始進行量產。
94 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 連續式電漿清洗機開發成功並開始銷售。
95 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盈餘轉增資 5,653 千元，實收資本額 62,183 千元。 ◆ 開始將電漿技術及設備引進非電子及民生工業，如塑膠及車用部品製造領域。
96 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 成功銷售電漿設備至生化醫學領域。
97 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 引進電漿設備至觸控螢幕製程應用。
98 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 進行電漿殺菌、廢氣處理及空氣淨化等應用之開發。
99 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 首度銷售電漿設備至美國半導體大廠，並獲得各項製程與安全認證，行銷網首度觸及亞洲以外領土；開啟高爾夫球製造製程中電漿應用與設備銷售。
100 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 現金增資 6,210 千元，實收資本額 68,393 千元。
101 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盈餘轉增資 20,518 千元，實收資本額 88,911 千元。 ◆ 成功開發連續式及捲對捲式電漿去膠渣機，並銷售至 IC 載板及軟板大廠。
102 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 成功引進並銷售電漿技術與設備於製鞋工業。
103 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 提供新式且低能耗電漿解決方案於太陽能產業，有效解決發電效率衰減問題。
104 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盈餘轉增資 17,782 千元，實收資本額 106,693 千元。
106 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盈餘轉增資 21,339 千元，實收資本額 128,032 千元。 ◆ 成功將電漿技術導入 5G 手機天線供應鏈之應用，並大量將電漿機台應用在 LCP 等高頻材料之製程；跨足歐洲市場之電漿設備銷售。
107 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 開發獨特電漿極化技術，成功地將此電漿技術應用於 5G 手機屏下指紋辨識晶片製造製程，並獲得美國半導體大廠之電漿設備認證
108 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盈餘轉增資 64,016 千元，實收資本額 192,048 千元。

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 現金增資 36,263 千元，實收資本額 228,311 千元。 ◆ 取得 ISO 9001 關於生產製造、設計開發、測試、設備銷售之組織管理系統認證;先進高溫電漿火炬技術開發完成，開始應用於固態廢棄物與廢油之處理，提供環保減廢之絕佳方案。
109 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 成功銷售各式高效能電漿蝕刻機(包含微波電漿蝕刻機以及反應性離子電漿蝕刻機)於晶圓及 IC 載板製程領域，特別是應用於各式高分子材料或金屬蝕刻。
110 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 針對晶圓提供數項的電漿解決方案，包括晶圓再生、電漿晶圓切割、電漿晶圓薄化，持續取得客戶的認證。
111 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盈餘轉增資 34,247 千元，實收資本額 262,558 千元。 ◆ 台南科技工業區新廠落成並啟用；開發電漿減碳應用。
112 年	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 員工認股權憑證執行轉增資 26,040 千元，實收資本額 288,598 千元。 ◆ 經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行，股票代號：7730。

三、經營理念

暉盛公司專注於本業之經營，以研發先進電漿技術為主軸，尖端技術服務為宗旨，提供高效能工業級表面處理解決方案為目標。暉盛公司掌握特殊優越的技術及堅強的研發團隊，重視技術之研發及業務行銷之拓展，建立以人才為本及永續經營的企業經營理念，並專注於整合技術能力，以良好的品質及服務獲取客戶肯定與信任，積極為客戶創造價值，成為客戶最終之首選供應廠商。

四、未來展望

1. 短期發展計畫

- (1) 5G 通訊產業鏈電漿應用及市場開發。
- (2) 連續式電漿設備硬體與軟體之推廣。
- (3) 高效能電漿蝕刻應用之開發(半導體、IC 載板、先進封裝、Micro-LED)。
- (4) 針對歐美日上游龍頭或系統大廠，進行重點式的合作。

2. 長期發展計畫

- (1) 開發歐美、東南亞 PCB 及半導體後段市場應用，並加強應用廣度。
- (2) 節能減碳新能源、空氣汙染防制(以工業用為主)之市場調查與開發。
- (3) 利用電漿環保、低能耗的技術特性，提供減碳及永續經營的製程方案。
- (4) 提高產品品質並強化售後服務，在經營上持續秉持永續經營的理念，建立企業優良文化，並積極參與公益活動，重視社會責任。
- (5) 掌握市場動向，擴大市場規模以開拓全球性電漿市場，並建立全球性之領導品牌。
- (6) 配合 5G、AI 高速網路及 VR/AR 應用等趨勢崛起，利用本公司專業技術結合其他專業領域，持續投入研發，並積極開發各項有利基之新產品，使產品多元化拓展更多市場應用。

主要業務項目：暉盛公司主要從事半導體產業、IC 載板與印刷電路板產業及光電產業等其製程所需電漿設備與解決方案之研發、生產及銷售。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

上游 零組件、原料、加工品供應商 中游 電漿設備設計、組裝與製造 下游 銷售對象

機構部品：真空腔體、骨架等



電控部品：電源供應器、電子與控制元件等

真空部品：真空 pump、真空壓力計、真空元件等

加工部品：電極加工件、機構加工件等

電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿極化機、電漿去光阻機、電漿去膠渣機、電漿鑽孔機、電漿表面改質機、電漿生化處理機、電漿廢氣處理設備、全氟化物電漿分解處理機、電漿廢水處理設備、電漿高溫減廢設備

半導體產業(晶圓廠、封裝廠、晶片廠等)
印刷電路板產業(IC 載板、HDI 板、Server 板、IC Probe 板、軟板、軟硬結合板等)
光電產業(LCD、OLED、觸控、LED 等)
其他電子與非電子產業(SMT、被動元件、生醫、塑膠業、車用部品、高爾夫球、化妝品等)

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	112年度 營收金額 (千元)	佔總營 收比重 (%)
電漿設備	<p>電漿清洗機</p> 	電子或非電子元件表面乾式清潔與改質，可適用於各式半導體、印刷電路板、光電、SMT、生醫、塑膠、車用部品等製程。	702,998	92.25
	<p>電漿蝕刻機</p> 	高分子或金屬材料表面進行乾式蝕刻，以應用於半導體、先進封裝、IC 載板、Micro-LED 等製程。		
	<p>電漿極化機</p> 	電漿針對壓電材料進行極化處理，以應用於屏下指紋辨識 Sensor、散熱裝置、運動 Sensor、健康相關監控 Sensor 製作之製程。		
	<p>電漿表面處理機</p> 	針對各式電子或非電子產品，進行表面性質的改變(例如親水性提升、粗糙度改善)，以利後製程之良率提升(例如改善鍍膜或印刷品質、貼合拉力提升等)。		
其他		主要係設備零件之買賣及維修服務等。	59,041	7.75
合計			762,039	100.00

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年 (自結數) (註2)	113年截 至1月份止 (自結數) (註2)
營業收入		446,213	279,922	450,936	809,578	762,039	32,895
營業毛利		155,358	110,858	171,875	313,543	288,457	12,085
毛利率(%)		34.82	39.60	38.12	38.73	37.85	36.74
營業外收入		2,343	9,292	3,510	32,518	31,109	6,504
營業外支出		(4,859)	(11,778)	(7,605)	(10,533)	(25,905)	(334)
稅前損益		77,206	41,744	75,715	215,722	167,422	14,047
稅後損益		62,308	36,189	61,071	171,556	133,867	11,305
每股盈餘(元)		2.72	1.38	2.33	6.53	5.00	0.39
股利發放	現金股利(元)	1.0	1.0	1.0	1.0	(註3)	—
	股票股利(資本公積轉資)(元)	—	—	—	—	(註3)	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	—	—	1.5	—	(註3)	—

註1：各年度財務資料經會計師查核簽證。108年度僅編製採我國企業會計準則之個體報表，故僅揭露個體數字；該公司自110年度起適用國際財務報導準則並編製合併財務報表，附列109年度比較數字。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註3：112年度盈餘分配尚未經董事會決議通過。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年 (自結數)(註2)
項目						
流動資產		455,512	558,876	594,536	830,919	817,185
不動產、廠房及設備		147,960	183,024	274,285	273,078	265,101
無形資產		443	3,641	3,205	2,496	2,278
其他資產		20,429	24,763	33,687	39,417	39,915
資產總額		624,344	770,304	905,713	1,145,910	1,124,479
流動負債	分配前	242,219	405,041	503,630	403,624	230,445
	分配後	265,050	427,872	526,461	429,880	(註3)
非流動負債		—	1,329	—	191,386	176,861
負債總額	分配前	242,219	406,370	503,630	595,010	407,306
	分配後	265,050	429,201	526,461	621,266	(註3)
股本		228,311	228,311	228,311	262,558	288,598
資本公積		22,600	22,600	22,600	22,600	55,333
保留盈餘	分配前	131,313	113,104	151,344	265,822	373,434
	分配後	108,482	90,273	128,513	239,566	(註3)
其他權益		(99)	(81)	(172)	(80)	(192)
權益總額	分配前	382,125	363,934	402,083	550,900	717,173
	分配後	359,294	341,103	379,252	524,644	(註3)

註1：各年度財務資料經會計師查核簽證。108年度僅編製採我國企業會計準則之個體報表，故僅揭露個體數字；該公司自110年度起適用國際財務報導準則並編製合併財務報表，附列109年度比較數字。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註3：112年度盈餘分配尚未經董事會決議通過。

TOP ^

最近三年度財務比率

年度		110年	111年	112年 (自結數)(註)
項目				
財務比率	毛利率(%)	38.12	38.73	37.85
	流動比率(%)	118.05	205.86	354.61
	應收帳款天數(天)	70	77	131
	存貨週轉天數(天)	345	215	165
	負債比率(%)	55.61	51.92	36.22

註：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)